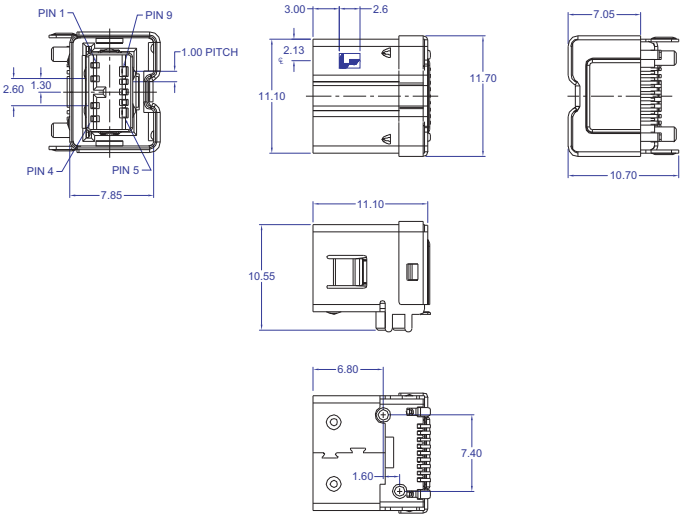
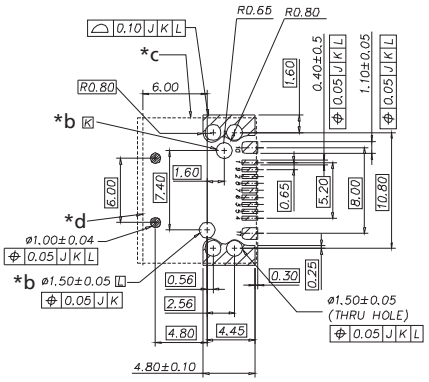
SMT



*a



*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen
printed circuit board layout, components side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à équiper

*b Loch für Positionierungszapfen
hole for positioning peg
perçage pour goujon de positionnement

*c Umriss des Steckverbinders
boundary of connector
contour d'embase

*d Leiterplattenrand
printed circuit board edge
bord de la carte imprimée

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
2301 F90V203	**9**	**100**

Verpackung: im Tablett
Packaging: in tray
Emballage: en tableau

2301

IEEE-1394b-Bilingual-Einbaukupplung, abgewinkelte Ausführung, mit Positionierungszapfen, für Leiterplatten, Surface-Mount-Technik, mit THT-Befestigung

1. Temperaturbereich -40 °C/+85 °C

2. Werkstoffe

Kontaktträger	LCP, V0 nach UL 94
Kontaktfeder	CuSn, unternickelt und vergoldet
Gehäuse	Cu-Legierung, vernickelt (lötbar)
Lötkontakt	CuSn, unternickelt und verzinnt

3. Mechanische Daten

Vibrationsfestigkeit	Unstetigkeiten < 1 µs
Steckkraft	≤ 39 N
Ziehkraft	≥ 10 N
Steckzyklen	≥ 1000
Kontaktierung mit	IEEE-1394b/IDB-1394-Steckern 231...

4. Elektrische Daten

Durchgangswiderstand	≤ 50 mΩ
Bemessungsstrom	1,5 A
Bemessungsspannung	30 V AC
Prüfspannung	100 V DC
Isolationswiderstand	≥ 10^8 Ω

2301

IEEE 1394b bilingual chassis socket, angular version, with positioning pegs, for printed cicuit boards, surface mounting technology, with THT fixing

1. Temperature range -40 °C/+85 °C

2. Materials

Body	LCP, V0 according to UL 94
Contact spring	CuSn, pre-nickeled and gilded
Housing	Cu alloy, nickeled (solderable)
Solder contact	CuSn, pre-nickeled and tinned

3. Mechanical data

Vibration resistance	discontinuities < 1 µs
Mating Force	≤ 39 N
Withdrawal force	≥ 10 N
Mating cycles	≥ 1000
Mating with	IEEE 1394b/IDB-1394 plugs 231...

4. Electrical data

Contact resistance	≤ 50 mΩ
Rated current	1.5 A
Rated voltage	30 V AC
Test voltage	100 V DC
Insulation resistance	≥ 10^8 Ω

2301

Embase femelle IEEE 1394b bilingue, version angulaire, avec goujons de positionnement, pour cartes imprimées, technique des montages en surface, avec fixation THT

1. Température d'utilisation -40 °C/+85 °C

2. Matériaux

Corps isolant	LCP, V0 suivant UL 94
Ressort de contact	CuSn, sous-nickelé et doré
Boîtier	Cu alliage, nicklé (soudable)
Contact à souder	CuSn, sous-nickelé et étamé

3. Caractéristiques mécaniques

Resistance contre vibrations	discontinuités < 1 µs
Force d'isertion	≤ 39 N
Force de séparation	≥ 10 N
Nombre de manœuvres	≥ 1000
Raccordement avec	connecteurs mâles IEEE 1394b/ IDB-1394 231...

4. Caractéristiques électriques

Résistance de contact	≤ 50 mΩ
Courant assigné	1,5 A
Tension assignée	30 V AC
Tension de claquage	100 V DC
Résistance d'isolement	≥ 10^8 Ω